



O NPM-W2 combina a colocação precisa de componentes, inspeção precisa de SPI e AOI e distribuição de adesivo reprodutivo em uma solução de alta velocidade.

NPM-W2

Maior produtividade e qualidade graças à integração dos processos de impressão, colocação e inspeção tornam o NPM-W2 uma das soluções pick-and-place mais flexíveis e versáteis do mercado.

Key Features

Equipado com uma cabeça de 12 bicos e pode colocar 38.500 componentes

Inspeção automática de depósitos de solda e componentes de acordo com os dados de produção

Compatível com mecanismo de descarga HDF, que garante uma dispensação sem contato de alta qualidade com um dispensador de válvula de parafuso



NPM-W2

<https://latam.connect.panasonic.com/mx/pt/produtos/smart-factory-solutions/npm-w2>

PCB dimensions (mm)	Single-laneBatch mounting2-positin mountingDual-laneDual transfer (Batch)Dual transfer (2-position)Single transfer (Batch)Single transfer (2-position)
Placement Head max Speed	38 500cph (0.094 s/ chip)
Placement Head Placement Accuracy (Cpk\geq1)	$\pm 40 \mu\text{m}$ / chip
Placement Head Component Dimensions (mm)	0402 chip ~ L 6 x W 6 x T 3
Dispensing Head	Dispensing speed:Dot dispensing: 0.16 s/dot (Condition : XY=10 mm, Z=less than 4 mm movement, No θ rotation) Draw dispensing: 4.25 s/component (Condition : 30 mm x 30 mm corner dispensing)*9Adhesive position accuracy (Cpk \geq 1) Dot Dispensing: $\pm 75 \mu\text{m}$ /dot Draw Dispensing: $\pm 100 \mu\text{m}$ /componentApplicable components Dot Dispensing: 1608 chip to SOP,PLCC,QFP, Connector, BGA, CSP Draw Dispensing: BGA, CSP
Resolution	2D inspection head (A)18 μm
View Size (mm)	44.4 x 37.2
Inspection Processing Time	Solder Inspection 0.35s/ View sizeComponent Inspection 0.5s/ View size
Inspection Object	Solder InspectionChip component: 100 μm x 150 μm or more (0603 or more)Package component: $\phi 150 \mu\text{m}$ or moreComponent Inspection: Square chip (0603 or more), SOP, QFP (a pitch of 0.4mm or more), CSP, BGA, Aluminum electrolysis capacitor, Volume, Trimmer, Coil, Connector
Inspection Items	Solder Inspection:Oozing, blur, misalignment, abnormal shape, bridgingComponent Inspection:Missing, shift, flipping, polarity, foreign object inspection
Inspection Position Accuracy	$\pm 20 \mu\text{m}$
No of Inspection	Solder Inspection : Max. 30 000 pcs./machine (No. of components :Max. 10 000 pcs./machine)Component Inspection: Max. 10 000 pcs./machine
Component Supply Taping	Tape : 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 44 / 56 mmMax.120 (Tape: 4, 8 mm)